```
DIALOG(R) File 351: Derwent WPI
(c) 2006 Thomson Derwent. All rts. reserv.
008320202
WPI Acc No: 1990-207203/199027
XRAM Acc No: C90-089856
 Novel polyepoxy resin with low viscosity - contains
 polyepoxy-radical-contg. oxycyclohexane skeleton(s) and organic cpd.
 residual radical
Patent Assignee: DAICEL CHEM IND LTD (DAIL )
Number of Countries: 001 Number of Patents: 002
Patent Family:
                             Applicat No
                                            Kind
                                                            Week
Patent No
             Kind
                    Date
                                                   Date
                  19900529 JP 88294442
                                             A '19881121 199027 B
JP 2140219
              Α
              B2 19960306 JP 88294442
                                                 19881121 199614
                                             Α
JP 96022902
Priority Applications (No Type Date): JP 88294442 A 19881121
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pq
                        Main IPC
                                     Filing Notes
JP 96022902
             B2
                   9 C08G-059/18
                                     Based on patent JP 2140219
Abstract (Basic): JP 2140219 A
        Epoxy resin is respresented by formula (I) where all or a part of X
    are composed of an epoxy-radical-contg. oxycyclohexane skeleton of
    formula (II). At least 1 of the skeleton (II) are contained. Y is OH or
    residual radical of organic carboxylic acid ester. R = organic cpd.
    residual radical with 'el' pieces of active H, n1, n2 nl are O or
    integera 1-100. Sum is 1-100. 'el' = integer 1-100.
        R is alcohols, phenols, carboxylic acids, amines, thiols.. Alcohols
    are methanol, hexanol, benzyl alcohol, ethyleneglycol, 1,4-butanediol,
    phenol, hydroquinone, bisphenol A, acetic acid, maleic acid,
    terephthalic acid, methylamine, toluenediamine, methylmercaptane,
    ethylene glycol dimercapto-propionate, poly-vinylalcohol, starch,
    cellulose, alkyd resin.
        ADVANTAGE - Prod. has low viscosity and good resistance to water.
    End-esterified epoxy resin gives much less viscosity yet with high
    melting pt. than with end OH. (9pp Dwg.No.0/0)
Title Terms: NOVEL; POLYEPOXIDE; RESIN; LOW; VISCOSITY; CONTAIN;
  POLYEPOXIDE; RADICAL; CONTAIN; OXY; CYCLOHEXANE; SKELETON; ORGANIC;
  COMPOUND; RESIDUE; RADICAL
Derwent Class: A21
International Patent Class (Main): C08G-059/18
File Segment: CPI
```

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-140219

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)5月29日

C 08 G 59/18

NHU

8416-4 J

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全9頁)

50発明の名称 エポキシ樹脂

> 20特 願 昭63-294442

22出 願 昭63(1988)11月21日

個発 明 者 酒 井 勝寿 広島県大竹市玖波6丁目8-5

勿出 願 人 ダイセル化学工業株式 大阪府堺市鉄砲町1番地

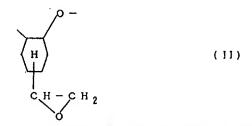
会社

明 田糸

- 1.発明の名称 エポキシ樹脂
- 2. 特許請求の範囲 下記一般式(I)

$$\begin{array}{c|c}
(X) & \hline
 & \uparrow \\
(X) & \hline
 & \uparrow \\
\hline
 & \downarrow \\
(X) & \hline
 & \uparrow \\
\hline
 & \downarrow \\
 & \downarrow \\
 & \uparrow \\
 & \downarrow \\
 & \uparrow \\
 & \downarrow \\
 & \uparrow \\
 & \downarrow \\
 & \downarrow \\
 & \uparrow \\
 & \downarrow \\$$

[但し、一般式(I)においてXはその全てまた は一部が下記一般式 (11) で表わされるエポキシ 基を有するオキシシクロヘキサン骨格で構成され、 該骨格(II)が少なくとも1分子中に1個以上含 まれることが必須である、YはOH(ただし、開 始剤がOHまたはCOOHを有していないアミン の場合にはH)、または有機カルボン酸エステル 残基を表わし, 少なくとも1分子中に1個以上の 該残基を含む。



Rは』ケの活性水素を有する有機化合物残基。 n1、n2 ……nlは0又は1~100の整数で、 その和が1~100である。』は1~100の整 数を表わす〕

で表わされるエポキシ樹脂。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、エーテル基とビニル性2重結合を合 わせ持つポリエーテル化合物のビニル性2重結合 をエポキシ化剤を用いてエポキシ化することによ って得られる脂環式エポキシ樹脂であって、かつ。 末端に有機カルボン酸エステル構造を有する新規 な脂環式エポキシ樹脂に関する。

さらに詳しくは、耐熱性、耐候性、耐水性が改

- 2 -

良され、かつ、粘度が低く吸水性が改良された新 想な脂環式エポキシ樹脂に関する。

[従来技術]

産業界において現在最も広く使用されているエポキシ樹脂はビスフェノールとエピクロルヒドリンとの反応によって製造される、いわゆる、エピービス型エポキシ樹脂である。

この樹脂は液体から固体まで幅広い製品が得られ、しかもエポキシ基の反応性は高く、ポリアミンで常温硬化できるという利点を有している。

しかしながら、その硬化物は耐水性に優れ、強 朝であるという特徴があるにもかかわらず耐候性 が悪いこと、耐トラッキング性など電気特性が悪 いこと、熱変形温度が低いことなどの欠点がある。

とくに最近、 超しSI などの封止用樹脂にフェノールやノボラック樹脂とエピクロルヒドリンと 反応させたエボキシ樹脂が使用されているが、 樹脂中に塩素が数 100 ppm 含まれ、それが電気 部品の電気特性を悪くするなどの問題が起きている。 塩素を含まず電気特性、耐熱性に優れたエボ

- 3 -

を含んではいるが、末端が O H 基であるため比較 的低分子量のものでも粘度が高くなってしまうこ と、また、硬化物の吸水率が高いなど一部問題が 残されている。

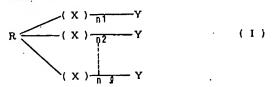
そのためにエポキシ樹脂を改質する試みがなさ れているが、充分なものは得られていない。

このような状況から本発明者らが検討した結果、前記公報に開示された脂環式エポキシ樹脂の分子末端のOH基の一部または全部にエステル結合を 導入することにより低粘度化を達成し、その結果、 硬化物の耐水性が改良されることを見出だし、本 発明に至った。

[発明の構成]

すなわち、本発明は

「下配一般式(I)



[但し、一般式(I)においてXはその全てまた

- 5 -

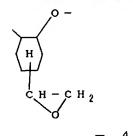
キシ樹脂としては脂環式エポキシ樹脂がある。

これらの樹脂のエボキシ基は、いわゆる、内部 エボキシ基であり、通常、酸無水物による加熱硬 化が行なわれているが、反応性が低いためポリア ミンによる常温硬化はできない。

そのため脂環式エポキシ樹脂の使用範囲を著し く狭いものにしている。

上記のような欠点を改良した脂環式エポキシ樹脂として例えば、特開昭60-166675号公報、同60-161940号公報(=USP 4.565,859)などに開示されたものがある。 [発明が解決しようとする課題]

しかしながら、上記のエボキシ樹脂は本発明の エボキシ樹脂と同様に前記(II)の構造



は一部が下記一般式(II)で表わされるエボキシ 基を有するオキシシクロヘキサン骨格で構成され、 酸骨格(II)が少なくとも1分子中に1個以上含 まれることが必須である、YはOH(ただし、開 始剤がOHまたはCOOHを有していないアミン の場合にはH)または有機カルボン酸エステル残 基を表わし、少なくとも1分子中に1個以上の該 残基を含む、

Rは』ケの活性水素を有する有機化合物残基, n1、n2……n』は0又は1~100の整数で、 その和が1~100である。』は1~100の整 数を表わす]

で表わされるエポキシ樹脂」

である.

- 6 -

次に本発明について詳述する.

本発明の(I)式で表わされる新規なエポキシ 歯脂において、Rは活性水器を有する有機化合物 残基である。

その前駆体である活性水素を有する有機物としては、アルコール類、フェノール類、カルボン酸類、アミン類、チオール類等があげられる。

アルコール類としては、1 価のアルコールでも 多価アルコールでもよい。

例えばメタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、ペンタノール、ヘキサノール、オクタノール等の脂肪族アルコール、ベンジルアルコールのような芳香族アルコール、トリエチレングリコール、ジエチレングリコール、アロピレングリコール、ジアロピレングリコール、 1.4ブタンジオール、 1.6ヘキサンジオール、ネオペンチルグリコール、オキシピバリン酸ネオペンチルグリコールエステル、シクロヘキサンジメタノール、グリセ

- 7 -

ロビルアミン、モノブチルアミン、ジブチルアミン、ペンチルアミン、ヘキシルアミン、シクロヘキシルアミン、オクチルアミン、ドデシルアミン、4,4'ージアミノジフェニルメタン、イソホロンジアミン、トルエンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、キシレンジアミン、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン、エタノールアミン等がある。

チオール類としてはメチルメルカプタン、エチルメルカプタン、プロピルメルカプタン、フェニルメルカプタン等のメルカプト類、メルカプトプロピオン酸の多価アルコールエステル、例えばエチレングリコールジメルカプトプロピオン酸エステル、トリメチロールプロパントリメルカプトプロピオン酸等があげられる。

さらにその他、活性水素を有する化合物として はポリビニルアルコール、ポリ酢酸ビニル部分加 水分解物、デンプン、セルロース、セルロースア リン、ジグリセリン、ポリグリセリン、トリメチロールプロパン、トリメチロールエタン、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトールなどの 多価アルコール等がある。

フェノール類としては、フェノール、クレゾール、カテコール、ピロガロール、ハイドロキノン、ハイドロキノンモノメチルエーテル、ピスフェノールA、ピスフェノールF、4,4'ージヒドロキシベンゾフェノン、ピスフェノールS、フェノール樹脂、クレゾールノボラック樹脂等がある。

カルボン酸類としてはギ酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、動植物油の脂肪酸、フマル酸、マレイン酸、アジピン酸、ドデカン2酸、トリメリット酸、ピロメリット酸、ポリアクリル酸、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸等がある。

また、乳酸、クエン酸、オキシカプロン酸等、 水酸基とカルボン酸を共に有する化合物もあげら れる。

アミン類としてはモノメチルアミン、ジメチル アミン、モノエチルアミン、ジエチルアミン、プ

- 8 -

セテート、セルロースアセテートブチレート、ヒドロキシエチルセルロース、アクリルポリオール 樹脂、スチレンアリルアルコール共重合樹脂、スチレンーマレイン酸共重合樹脂、アルキッド樹脂、ポリエステルポリオール樹脂、ポリエステルカルボン酸樹脂、ポリカプロラクトンポリオール樹脂、ポリプロピレンポリオール、ポリテトラメチレングリコール等がある。

また、活性水業を有する化合物は、その骨格中に不飽和2重結合を有していても良く、具体例としては、アリルアルコール、アクリル酸、メタクリル酸、3-シクロヘキセンメタノール、テトラヒドロフタル酸等がある。

これら活性水索を有する化合物であればどのようなものでも用いることが出来, それら 2 種以上を混合して用いてもよい。

本発明の一般式(I)で扱わされる新規なエボ

- 10 -

– 9 –

キシ樹脂において、Xはその全てまたは一部が下配一般式(II)で表わされるエボキシ基を有するオキシシクロヘキサン骨格で構成され、酸骨格(II)が少なくとも1分子中に1個以上含まれることが必須である。

上記基本骨格(II)はブタジエンの二量化により得られる4ービニルシクロヘキセンを部分エポキシ化した4ービニルシクロヘキセン-1ーオキシドが開環した下記骨格(III)

n = 2 ~ 2 5 で表わされるα-オレフィンエポ キサイド

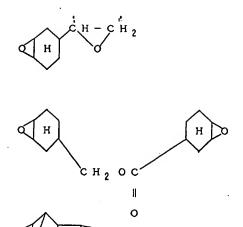
のビニル基をエポキシ化剤を用いてエポキシ化したものである。

一般式(I)において、Xは(III)単独の場合だけでなく、4ービニルシクロヘキセンー1ーオキシド以外のエポキシ基を1個以上有するエポキシ化合物が開環した骨格を含んでいても差し支えはない。エポキシ基を1個以上有する化合物は2種類以上使用しても良い。

具体的には以下のような化合物が挙げられる。 CH₂-CH₂, CH₃-CH-CH₂

- 14 -

- 13 -



などの脂環型エポキシ樹脂

- 15 -

脂において, n1 、n2 …… n l は 0 または 1 ~ 1 0 0 の整数で、その和が 1 ~ 1 0 0 である。

n 1 、 n 2 … … n 』の和が 1 0 0 を越えると分子量が高くなり過ぎて実際上は使用できるものとはならない。

』は一般式(I)で表わされるエポキシ樹脂におけるRの前躯体である開始剤の活性水素を有する化合物の活性水素の数であり、1~100の整数である。

一般式(I)で表わされるエポキシ樹脂におけるYはその全てまたは一部が有機カルボン酸エステル残基で構成され、少なくとも1分子中に1個以上の該残基を含むことが必須である。

有機カルボン酸エステル残基としては、ギ酸、 酢酸、プロピオン酸などのエステル残基を挙げる ことができる。

また、Yの一部がOHのままであっても良い。

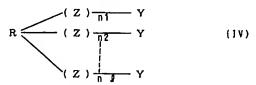
さて、一般式 (I) で表わされる本発明のエポキシ樹脂を得るためには先ず、前記各種の活性水業を I 個有する化合物とエポキシ基を 1 個以上有

本発明の一般式 (I) で表わされるエポキシ樹 - 16 -

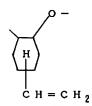
する化合物 (4-ビニルシクロヘキセン-1-オ キシドを含む)とを触媒存在下で反応させる。

この反応で得られる化合物は一般式(I)で表わされるエポキシ樹脂のYの部分が全てOH基, Xの部分の閉鎖が全てビニル基であるポリエーテル化合物である。

即ち、以下の構造を有している。



「ただし、Zは



R, 1 および n 1 、 n 2 … … n 1 は前配一般 式 (I) の場合と同じである」

反応時に用いられる触媒としてはメチルアミン、

- 18 -

エチルアミン、アロビルアミン、ピペラジン等の ない類、ピリジン類、イミグリール類等の有機と の4級アンモニウム塩、酢酸、プロピイン 酸等の有機酸類、塩酸等の無機酸、ナトラート等のアルカリ金属類のアルコラート ト類、KOH、NaOH等のアルカリ類、BF3、 スnCl2、AlCl3、SnCl4等のルイス 酸又はそのコンプレックス類、トリエチルアルミ こウム、ジエチル亜鉛等の有機金属化合物をあげ ることができる。

触媒の量は種類によって異なるが、出発原料に 対して 0 . 0 1 ~ 1 0 %、好ましくは 0 . 1 ~ 5 %の範囲で使用することができる。

反応温度は-20~200℃、好ましくほ0℃ ~120℃である。

反応は溶媒を用いて行なうこともできる。

溶媒としては活性水素を有しているものは使用 することができない。

すなわち、アセトン、メチルエチルケトン、メ

- 19 -

際上使用できるものとはならない。

また、エポキシ基を 2 個以上有する化合物を使用する時は 4 ービニルシクロヘキセンー 1 ーオキシドに対して 5 0 モル%以内になるように混合する。 5 0 モル%を 越えるように混合すると分子量が高くなりすぎて実際上使用できるものとはならない。

次に、一般式(IV)で表わされるポリエーテル化合物の末端〇H基のエステル化反応の部分について述べる。

エステル化剤としてはギ酸、酢酸、プロピオン 酸などの有機カルボン酸類およびその塩、塩化ア セチル、塩化ベンゾイルなどのハロゲン化アミン 類、無水酢酸、無水プロピオン酸などの有機カル ボン酸無水物などを挙げることができる。

・ また、酢酸エチル、酢酸ブチルなどのエステル 類とのエステル交換反応を行なっても良い。

エステル化反応およびエステル交換反応の際, 触媒は使用しなくても良いが、硫酸、トルエンス ルホン酸などのプロトン酸、BF3、SnC』3 チルイソブチルケトンのようなケトン類、ベンゼン、トルエン、キシレンのような芳香族溶媒その他エーテル、脂肪族使化水素、エステル類等を使用することができる。

反応に供する原料の仕込みモル比は以下の通りである。

開始剤である活性水楽を有する化合物1モルに対して4ービニルシクロヘキセン-1ーオキシドを1~100モル、4ービニルシクロヘキセン-1ーオキシド以外のエポキシ基を1個以上有する化合物を99~0モルの範囲で混合して、エポキシ化合物の合計が100モル以下になるようにして反応させる。

エポキシ化合物の合計100モル中4ービニルシクロヘキセンー1ーオキシドが1モル以下の場合にはビニル基の含有量が少くなるため、シクロヘキサン骨格の特徴が出ない。

逆に、エポキシ化合物の合計が100モルを越えると活性水素を有する化合物の開始剤としての 働きがなくなるうえ、分子量が高くなりすぎて実

- 20 -

などのルイス酸およびその錯塩、ビリジン、Na OHなどの塩基類など通常用いられる触媒を使用 することもできる。

触媒の使用量は種類によって異るが、出発原料 に対して10%以下、好ましくは5%以下である。

エステル化剤の種類と量、反応条件を選定する ことにより末端の〇H茎、カルボン酸エステル茎 の比率を調節することができるが、1分子中1つ 以上の〇H茎をエステル化する必要がある。

エステル化反応およびエステル交換反応の温度 は-20~200℃, 好ましくは, 0~200℃ である。

反応をコントロールするために溶媒を使用する こともできる。

以上のようにして得られた末端〇H基の一部をカルボン酸エステル化した一般式(IV)で表わされるポリエーテル化合物の側鎖のビニル基をエポキシ化することにより一般式(I)で表わされるエポキシ樹脂が得られる。

次に、エポキシ化反応の部分について述べる。

- 22 -

- 21 -

エポキシ化剤を作用させる場合,用い得るエポキシ化剤としては過酸類,およびハイドロパーオキサイド類をあげることができる。

過酸類としては過ギ酸,過酢酸,過安息香酸, トリフルオロ過酢酸などがある。

このうち、過酢酸は工業的に大量に製造されており、安価に入手でき、安定度も高いので好ましいエポキシ化剤である。

ハイドロパーオキサイド類としては過酸化水素、 ターシャリブチルハイドロパーオキサイド、クメ ンパーオキサイド等がある。

エポキシ化の際には必要に応じて触媒を用いる ことができる。

例えば、過酸の場合、炭酸ソーダ等のアルカリ や硫酸などの酸を触媒として用い得る。

. また、ハイドロパーオキサイド類の場合、タングステン酸と苛性ソーダの混合物を過酸化水素と、あるいは有機酸を、過酸化水素と、あるいはモリブデンヘキサカルボニルをターシャリブチルハイドロパーオキサイドと併用して触媒効果を得るこ

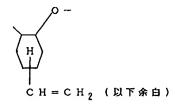
- 23 -

の目的に応じて変化させることができる。

エポキシ基が多い化合物が目的の場合, エポキシ化剤は不飽和基に対して等モルかそれ以上加えるのが好ましい。

ただし、経済性、及び次に述べる副反応の問題 から2倍モルを越えることは通常不利であり、過 酢酸の場合1~1.5倍モルが好ましい。

エポキシ化反応の条件によってオレフィン基の エポキシ化と同時に原料中の置喚基



とができる。

エポキシ化反応は、装置や原料物性に応じて溶 媒使用の有無や反応温度を調節して行なう。

用いるエポキシ化剤の反応性によって使用できる反応温度域は定まる。

好ましいエポキシ化剤である過酢酸についてい えば0~70℃が好ましい。

○℃以下では反応が遅く、70℃を越える温度では過酢酸の分解が生じる。

また、ハイドロパーオキサイドの1例であるターシャルブチルハイドロパーオキサイド/モリブデン二酸化物ジアセチルアセトナート系では同じ理由で20℃~150℃が好ましい。

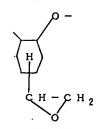
溶媒は原料粘度の低下, エポキシ化剤の希釈に よる安定化などの目的で使用することができる。

過酢酸の場合であれば芳香族化合物, エーテル化合物, ケトン化合物等を溶媒として用いることができる。

不飽和結合に対するエポキシ化剤の仕込みモル 比は不飽和結合をどれくらい残存させたいかなど

- 24 -

や生成してくる



がエポキシ化剤と副反応を起こした結果、変性された置換基

が生じ、目的化合物中に含まれてくる。

3 者の混合物の生成比は混合比率, エポキシ化 剤の種類、エポキシ化剤オレフィン結合のモル比、 反応条件などによって定まる。

- 26 -

なお、変性された置換基はエポキシ化剤が過酢 酸の場合、下のような構造のものが主であり、生成したエポキシ基と副生した酢酸から生じる。

一般式(I)で表わされる本発明の脂環式エポキシ樹脂中のBに結合した置換基は以下のようになるのが好ましい。

とも1個以上含まれることが必須である。

反応の結果、得られる化合物、すなわち、本発明の一般式(I)で表わされる脂環式エポキシ樹脂中のXは前記3種類の置換基の混合物となる。

- 27 -

析したところトリメチロールプロパン、4ービニルシクロヘキセン-1-オキシドがほとんど消失していることを確認できた。

続いて、無水酢酸 9 7 g (0 . 9 5 モル) を加 えて 8 0 ℃で 3 時間加熱した。

続いて、純水で3回水洗を行ない、溶媒を除去した。 赤外線吸収スペクトル分析により末端の O H 基が消失していることを確認した後、過酢酸 3 2 3 g を酢酸エチル溶液として 5 0 ℃に保持しながら 4 時間かけて滴下した。

純水で洗浄した後酢酸エチル層をロータリーエ パポレーターで濃縮し、得られた化合物の構造を ガスクロマトグラフィーおよびNMRを用いて分 析した結果、以下の通りであった。

[ただし, n1+n2+n3=平均15,Xは以下のビニル基を有するオキシシクロヘキサン骨格

なお、上記エポキシ化反応を行なう際に用いるエポキシ化剤が過酢酸の場合、ビニル基に対する 仕込みモル比を 0 . 1 ~ 2 . 0 好ましくは 0 . 5 ~ 1 . 5 にする。

0.1以下ではエポキシ樹脂として十分な性能をもつものが得られず2.0以上の仕込みは意味がない。

このようにして合成したエポキシ化合物は濃縮 等通常の化学工学的手段によって反応粗液から取 り出すことができる。

次に実施例を挙げて本発明を説明する。

「実施例」

〈合成例-1〉

トリメチロールプロパン38g(0.28モル) と4ービニルシクロヘキセン-1ーオキシド52 7g(4.25モル)を混合し、続いてBF₃エーテラート10%酢酸エチル溶液126gを4時間かけて滴下し反応させた。

この時、滴下中系内は50℃に保った。

滴下終了後,ガスクロマトグラフィーにより分

- 28 -

〈合成例一2〉

メタノール32g(1モル),4ービニルシクロヘキセン-1ーオキシド327g(3モル),無水酢酸153g(1.5モル),過酢酸228g(1モル)を用いた以外は合成例-1と同様にして対応するエポキシ樹脂を得た。

〈合成例一3〉

エチレングリコール62g(1 モル)、4 ーピニルシクロヘキセンー1ーオキシド248g(2 モル)、紙水酢酸204g(2 モル)、過酢酸152g(2 モル)を用いた以外は合成例-1 と同様にして対応するエポキシ樹脂を得た。

〈合成例一4〉

トリメチロールプロパン134g(1モル)と

- 30 **-**

4-ビニルシクロヘキセン-1-オキシド327g(3モル), 無水酢酸367g(3.6モル) 過酢酸228g(3モル)を用いた以外は合成例-1と同様にして対応するエポキシ樹脂を得た。 〈比較合成例-1~4〉

合成例-1~4における無水酢酸を用いた酢化 反応を省略した以外は合成例-1と同様にして末端にOH基を有するエボキシ樹脂を得た。

合成例-1~4および比較合成例-1~4で得たエポキシ樹脂の軟化点と粘度を測定した結果を表-1に示す。

「応用例」

〈合成例-1〉および〈比較合成例-1〉で得たエポキシ樹脂1.0当量にそれぞれフェノールノボラック型エポキシ樹脂(群栄化学:PSM-4300)1.0当量およびトリフェニルフォスフィン0.5%を表1に示す配合量で使用してエポキシ樹脂組成物を得た。これらのエポキシ樹脂組成物を粉砕後、150℃で30分間プレス成形してさらに200℃で2時間かけて硬化させた。

- 31 -

続いてプレッシャークッカーテスト(121℃、95%RH、144時間)を行ない、吸水率を測定したところ、比較例-1のエポキシ化合物では3、3%であったのに対して実施例-1のものは2、6%であった。

[発明の効果]

このようにして合成した本発明のエポキシ樹脂は低粘度のグレードのものを製造することが可能であり、耐水性などに優れ、各種の用途に供することができる。

表 - 1

	実 施 例	比較例
	(末端エステル化)	(末端〇H基)
1	軟化点70℃	軟化点50℃
2	4 6 1 cp	1060cp
3	6 8 cp	2000cp
4	9 2 O cp	100000cp以上

特許出願人

ダイセル化学工業株式会社

- 32 -